

## 低挥发导热硅胶片

TP400-H50-L是一款低挥发导热垫片，使用硅胶与导热陶瓷填料经由特殊工艺加工而成，双面自粘，低压缩力下表现出良好的导热性能和电气绝缘性能，在-40°C~200°C可以稳定工作，满足UL94 V-0的阻燃等级要求。

### 特性和优点

- 导热系数3.5W/(m·K)
- 低压缩力应用
- 双面自粘
- 高电气绝缘
- 良好耐温性能
- 低挥发
- 容易装配可重复使用

### 典型应用

- LCD背光模块
- 网络通讯设备
- 高速大存储驱动
- 汽车发动机控制单元
- 冷却器件到底盘或框架之间
- 平面显示器

### 典型属性

属性	典型值	测试方法
颜色	白色	目视
厚度 (mm)	0.5~6.5	ASTM D374
密度 (g/cc)	3.15	ASTM D792
硬度 (Shore 00)	50	ASTM D2240
重量损失 (% @150°C)	<0.2	ASTM E595-07
低分子硅氧烷含量D3~D10 (ppm)	≤50	/
挥发冷凝物含量	无挥发冷凝物	玻璃瓶烘烤180°C/8h,目测
耐温范围 (°C)	-40~200	/
防火性能	V-0	UL 94
保质期 (月)	12	温度<40°C避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压 (kV/mm)	≥6.0	ASTM D149
介电常数 (@10MHz)	7.3	ASTM D150
体积电阻率 (Ω·cm)	10 <sup>13</sup>	ASTM D257
导热性能		
导热系数 (W/(m·K))	3.5	ISO 22007-2
热阻 (°C·in <sup>2</sup> /W @20psi,1.0mm)	0.25	ASTM D5470